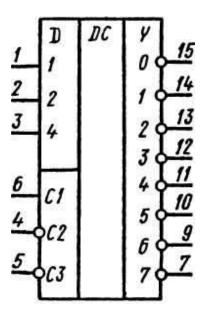
КР1533ИД7, **КФ**1533ИД7, **ЭКФ**1533ИД7

Микросхемы представляют собой сдвоенный дешифратор-демультиплексор 3-8. При работе в качестве дешифратора входы D1, D2, D4 являются информационными, входы C1, $\overline{C2}$, $\overline{C3}$ - стробирующие; при работе в качестве демультиплексора 1-8 входы D1, D2, D4 являются селектирующими, роль информационного входа играет C1, а $\overline{C2}$ и $\overline{C3}$ являются сторобирующими. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г, 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный нулевого разряда D1; 2 - вход информационный первого разряда D2; 3 - вход информационный второго разряда D4; 4 - вход разрешения $\overline{C2}$; 5 - вход разрешения $\overline{C3}$; 6 - вход разрешения C1; 7 - выход $\overline{Y7}$; 8 - общий; 9 - выход $\overline{Y6}$; 10 - выход $\overline{Y5}$; 11 - выход $\overline{Y4}$; 12 - выход $\overline{Y3}$; 13 - выход $\overline{Y2}$; 14 - выход $\overline{Y1}$; 15 - выход $\overline{Y0}$; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИД7, КФ1533ИД7, ЭКФ1533ИД7

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 B ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 B
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,5 B
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ -1,5 B
Входной ток низкого уровня	≤ -0,2 mA
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Ток потребления	≤ 8,5 MA
Выходной ток	-10 -112 мА
Входной пробивной ток	≤ 0,1 MA

Время задержки распространения при включении:	
- по входам 46	≤ 27 нс
- по входам 13	≤ 26 нс
Время задержки распространения при выключении:	
- по входам 46	≤ 25 нс
- по входам 1 . 3	< 28 HC

Таблица истинности

Вход				Выход								
C1	<u>C</u> 2*	D1	D2	D4	<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>7</u> 5	<u>76</u>	<u>77</u>
Х	1	Χ	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1
0	Χ	Χ	Χ	Χ	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Примечание. $C2^* = C2 + C3$

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	.4,55,5 B
Входное напряжение низкого уровня	.00,8 В
Входное напряжение высокого уровня	.25,5 B
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	.5,5 B
Температура окружающей среды	10+70 °C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм;

допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше $60\,^{\circ}\text{C}.$

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.